산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 5. 14.(일) 11:00 < 5.15.(월) 조간 > 배포 2023. 5. 12.(금)

국내 소부장 기술 자립화에 민간 투자 자본 860억 원 규모 유치

- 기업형 벤처캐피탈 등 37개 투자사(社) 소부장 기술자립화에 약 860억 원 투자

- 민간 투자와 연계해 소부장 기업에 향후 3년간 812억 원 정부 연구개발(R&D) 지원

국내 32개 중소·중견 소부장 기업들의 유망 기술개발에 대해 기업형 벤처캐피탈(CVC) 등 37개 투자사(社)가 860억 원 규모의 자본투자에 나선다.

산업부는 5월 15일 소부장 투자연계형 연구개발(R&D) 지원 대상으로 32개 소부장 기업을 선정하고, 민간투자 860억 원에 더해 향후 3년간 812억 원의 정부 연구개발(이하 R&D) 자금을 매칭으로 지원하여 민간 주도의 기술개발을 뒷받침하겠다고 밝혔다.

이번에 선정된 과제*들은 자유공모 방식으로 선정된 것으로 반도체, 디스플레이 등 주력산업 분야 외에 바이오, 우주항공 등 신성장 분야도 다수 포함되어 해당 분야에 대한 민간투자사(社)들의 관심도가 높은 것으로 나타났다.

* 반도체(3), 디스플레이(1), 전기전자(9), 자동차(5), 기계(1), 화학(1), 바이오(10), 우주항공(2)

바이오분야에서는 의약 제조공정용 멤브레인 제조기술, 메신저리보핵산(mRNA) 전달을 위한 고분자소재 등 기술자립을 지원하고, 우주항공분야는 극저온 추진제 탱크 및 발사체용 합금소재 개발 등의 기술자립을 추진한다.

특히, 올해에는 기업 당 민간 투자금액이 '20년 11.9억 원에서 '23년 26.8억 원으로 증가하는 등 역대 최대로 우수 기술력을 보유한 소부장 기업에 대한 민간투자는 지속 확대되고 있는 것으로 나타났다.

최근 3년간 지원된 116개 소부장 기업의 경우 약 1,860억 원의 민간 투자에 더해 정부 연구개발(R&D) 투자 약 2,870억 원 등 총 4,730억 원 규모의 투자를 받았으며, 지원된 116개 기업 중 45개 기업이 약 3,000억 원의 후속 투자유치에 성공하는 등 중소·중견 소부장 기업의 성장사다리 역할을 하고 있다.

산업부는 우수 소부장 기술을 보유한 기업에 대한 연구개발(R&D) 지원을 통해 민간투자 유치가 확대될 수 있도록 노력하는 한편, 소부장 특화단지 지정, 수요-공급기업 간 협력모델 확대 등 소부장 협력생태계도 지속 강화해나갈 계획이다.

담당 부서	산업공급망정책관 소재부품장비개발과	책임자	과 장	김영윤 (044-203-4920)
		담당자	사무관	서주원 (044-203-4922)

대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 1 '23년 소부장 투자연계형 R&D 선정리스트

(단위 : 백만원)

분야	과제명	주관기관	'23년 정부 출연금
반도체	SiC bare 및 Epi 웨이퍼자동화 검사 장비·불량검출·분류기술 개발	위브	679
	구리다이아몬드 복합소재 기반 화합물 반도체 패키지용 방열소재 개발	더굿시스템	679
	비휘발성 RAM인 14nm급 128Mbit Smart STT MRAM 개발	넷솔	679
디스플레이	ARVR용 5000ppi급 양산용 OLEDoS FMM(Fine Metal Mask) 개발	오럼머티리얼	679
전기전자	폐 LFP 이차전지의 유가금속 회수를 위한 중저온 건식 재활용 개발	알디솔루션	574
	고분자 접착 필름을 활용한 PEMFC Stack UnitCell 개발	시너지	679
	60Ah이상 이차전지의 고강도 고안전성 Al Pouch Film 개발	릴엠	679
	이차전지 탄소저감 건식공정용 바인더 및 제조 공정 개발	씨엔피솔루션즈	582
	5G 무선백홀 및 초고이득 빔포밍 어레이 안테나 시제품 개발	밀리웨이브	679
	VbyOne multilane 수용형 CMOS 무선 기술 개발	와이젯	679
	3D 깊이카메라 및 딥러닝 기반 식육 품질관리 자동화시스템 개발	엠트리센	679
	머신러닝 오퍼레이션(MLOps) 시스템 및 고도 알고리즘광학계 개발	아이브	679
	5MHz 싱글밴드 무선전송기술을 이용한 2000픽셀 전자망막 개발	셀리코	679
자동차	20um이하 박막 특수 아크릴전착 절연코팅 기술개발	대영엔지니어링	582
	VCSEL 기반 다중 채널 라이다 송신 모듈 개발	하나옵트로닉스	582
	SiC 전력반도체용 Usable Area 96% 이상 고품질 SiC Epitaxy 개발	아르케	679
	신뢰성이 확보된 30kW급 2단 터보공기압축기 및 인버터 개발	티앤이코리아	679
	All In One C ITS 레이더의 개발	비트센싱	679
기계	Cloud Edge AI 융합형 실내외 딜리버리 로봇 개발	폴라리스쓰리디	679
화학	24KV급 바이오기반 저탄소 에폭시 절연소재 개발	제일화성	679
바이오	PCR 수준의 고민감도 다중 신속진단 키트 개발	유니크닷	679
	양산용 150nm급 필터링 시스템 개발	메타포어	679
	세포추출(유전자) 유래물질의 서방형 복합제제 개발	라트바이오	679
	0.2 micron급 셀룰로오스 아세테이트 멤브레인 개발	폴리윅	450
	혈중 순환태아세포 분리 및 선별 자동화 플랫폼 개발	씨티셀즈	679
	인공혈소판 용해물(iahPLysTM) 제품 개발	듀셀바이오테라퓨틱스	679
	조직 선택적 mRNA 전달을 위한 고분자 소재 라이브러리 구축	옴니아 메드	679
	엑스선 검사 장비용 냉음극 기반 디지털 엑스선 발생장치 개발	도프	679
	극저온 초음속 미세입자 기반 경피약물전달 원천기술 개발	리센스메디컬	679
	폐암 조기진단을 위한 혈액 내 순환 종양 DNA 탐침 시약 개발	클리노믹스	679
우주항공	1.6m급 라이너리스 탄소복합재 극저온 추진제 탱크 제조기술 개발	페리지에어로스페이스	679
	발사체 1단용 지상 추력 50 kN 급 케로신액체산소 추력기 개발	우나스텔라	576
합계			**21,000**

* R&D 종료 전 투자자금 회수 등 의무사항 불이행 시 변동 가능

참고 2 소부장 투자연계형 R&D 주요내용

1. 사업개요

○ **(주요내용) 민간 투자유치*에 성공한 우수 소부장 기업**을 대상으로 **기술개발을 지원**하여 정부 R&D 사업화 성공률 제고(年 최대 10억원)

* 정부 R&D 출연금 대비 30% 이상 민간 투자확보 필요

○ **(현황)** 최근 3년간('20~'22) 116개 기업에 민간 투자 1,853억원, 정부 R&D 2,863억원 지원, '23년 32개 기업에 정부 R&D 812억원 지원

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
선정기업(개)	44	45	27	32
정부 지원 R&D(억원, A)	1,061	1,108	694	812
민간 투자 규모(억원, B)	526	841	486	858
정부R&D 대비 민간투자(%, B/A)	49.6	75.9	70.7	104.4

2. 추진성과 : 적재적소에 대규모 유동성 공급으로 R&D 효과성 개선

1 **(기업 성장사다리 역할)** 기술력은 있으나, 자금 부족으로 사업화에 어려움을 겪는 기업에 **민간투자 연계**로 **대규모 유동성 공급***

* (지원규모) '00~'23년 총 911개社에 대해 정부 R&D 투자 1조 6,478억원 및 민간투자금 1조 4,567억원 등 총 3조 1,045억원 투자자금 조성

2 **(높은 사업화 성공률)** 연구개발 및 사업화장치·설비 등 기반시설 구축으로 R&D 성공률 제고 및 강소형 기업으로의 성장기반 마련

* 소재부품(투자연계형) 수행기업의 사업화 성공률은 산업부 전체 R&D 성공률의 1.5배 수준

구분	소재부품(투자연계형)	소재부품 R&D 전체	산업부 R&D 전체
사업화 성공률	61.9%	52.2%	43.1%

3 **(IPO 성공)** '00~'22년, 758개 비상장 선정기업 중 **114개사(15%)**가 **IPO 성공**, 일반기업 대비 높은 상장비율 및 짧은 상장기간 소요

* 소재부품(투자연계형) 수행기업의 IPO 성공률은 15%로 일반기업 3.6%의 4배이며, IPO 소요기간은 일반기업의 16.2년 대비 적은 14년 소요

참고 3 투자연계형 R&D 우수사례

1 예스파워테크닉스 (2019년 선정기업, '22년 5월 SK(주)에 인수합병)

○ 예스파워테크닉스는 **SiC전력반도체 생산** 기업으로, '19년 퀀텀벤처스 코리아로부터 **15억원 투자유치**에 성공하였으며, **지주사 SK에 인수 합병**(기업가치 ('19년) 415억원 → 인수 당시 : 1,058억원)

○ SK㈜는 ㈜예스파워테크닉스의 SiC MOSFET* 전력 반도체 설계/생산 기술력을 내재화 하여, **미래 핵심 신사업으로 추진**

* SiC MOSFET : 탄화규소(Silicon Carbide) 산화막 반도체 전계효과 트랜지스터

2 레이저쎌 (2020년 선정기업, '22년 6월 코스닥 상장)

○ 레이저쎌은 **세계 최초 면광원 레이저 기반 기술**을 활용한 **반도체 리플로우 공정 장비** 시리즈 개발 기업

– 레이저쎌이 개발한 장비는 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 후(後) 공정에 해당하는 패키징 공정 중 **접합 과정에 사용**

○ 리플로우, 열 압착 접합 방식 등 기존 기술들의 단점을 보완해 기판이나 칩이 휘는 문제와 생산성이 떨어지는 한계 극복하여, 기존 반도체 패키징 방식에 비해 **효율성을 최대 15배** 높임

*** 기업가치 ('20년) 381억 원 → 현재 : 526억 원**

3 대진첨단소재 (2020년 선정기업, '22년 140억 원 규모 시리즈 D 유치)

○ 대진첨단소재는 이차전지용 패키징 소재 전문기업으로 **창업 3년 만에 누적 투자 금액 398억 원 유치**(기업가치 1,800억 원)에 성공

○ 대진첨단소재는 투자금을 바탕으로 글로벌 진출을 위한 해외 법인설립 및 생산공장(미국, 필리핀, 폴란드 등)을 구축하였으며, **전 세계 42개국에 수출** (직수출 최근 3년간 평균 성장률 740%)

*** 기업가치 ('21년) 1,000억 원 → 현재 : 1,800억 원**